



平成21年3月期 第3四半期決算短信

平成21年2月3日

上場会社名 株式会社 リヨーサン
 コード番号 8140 URL <http://www.ryosan.co.jp>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長
 問合せ先責任者 (役職名) 常務取締役財務本部長
 四半期報告書提出予定日 平成21年2月13日

(氏名) 三松 直人
 (氏名) 関 晴光

TEL 03-3862-2591

上場取引所 東

(百万円未満切捨て)

1. 平成21年3月期第3四半期の連結業績(平成20年4月1日～平成20年12月31日)

(1) 連結経営成績(累計)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益		(%表示は対前年同四半期増減率)
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	
21年3月期第3四半期	182,481	—	6,129	—	7,114	—	4,133	—	
20年3月期第3四半期	216,293	△6.8	8,118	18.2	8,661	21.8	5,145	5.3	

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
21年3月期第3四半期	117.55	—
20年3月期第3四半期	142.22	—

(2) 連結財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率		1株当たり純資産	
	百万円		百万円		%	円 銭		
21年3月期第3四半期	161,287		117,184		72.6	3,352.19		
20年3月期	174,022		118,911		68.3	3,348.70		

(参考) 自己資本 21年3月期第3四半期 117,074百万円 20年3月期 118,782百万円

2. 配当の状況

(基準日)	1株当たり配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	年間
20年3月期	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
21年3月期	—	40.00	—	40.00	80.00
21年3月期(予想)	—	40.00	—	40.00	80.00

(注)配当予想の当四半期における修正の有無 無

3. 平成21年3月期の連結業績予想(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	
通期	220,000	△23.1	6,000	△44.1	7,000	△37.9	4,000	△40.6	114.00

(注)連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 有

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) 無

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 有

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更(四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの)

① 会計基準等の改正に伴う変更有

② ①以外の変更 無

[(注)詳細は、5ページ【定性的情報・財務諸表等】4. その他をご覧ください。]

(4) 発行済株式数(普通株式)

- ① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 21年3月期第3四半期 36,500,000株
- ② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期 1,575,264株
- ③ 期中平均株式数(四半期連結累計期間) 21年3月期第3四半期 35,167,463株
- 20年3月期 36,500,000株
- 20年3月期 1,028,717株
- 20年3月期第3四半期 36,182,249株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

〔業績予想の利用について〕

業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 平成19年3月14日)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用方針」(企業会計基準適用指針第14号 平成19年3月14日)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

(1) 全体の概況

当第3四半期連結累計期間（平成20年4～12月）のマクロの経済環境は、サブプライムローンバブルの崩壊により、100年に一度の津波と表される金融危機が発生し、実体経済の落ち込みと連鎖する中で、世界的な景気後退局面を迎えるました。加えて日本企業においては、急激なる円の独歩高が更に企業業績に悪影響を与えております。

一方、我々が従事しておりますエレクトロニクス業界では、急激な需要減少から、メーカー各社がかつて無い生産調整を進めました。

このような厳しい情勢下で、当社企業グループは、業績向上を果たすため第7次中期経営計画の「成長戦略」に取り組むと共に、「収益体质の改善」に取り組んでまいりました。しかしながら、半導体、電子部品の需要が急速に減少したことから、当第3四半期連結累計期間の売上高は、前年同期比15.6%減の1,824億81百万円となり、営業利益61億29百万円（前年同期比24.5%減）、経常利益71億14百万円（前年同期比17.9%減）、四半期純利益41億33百万円（前年同期比19.7%減）と減収減益の結果となりました。

(2) 事業の種類別セグメントの業績概況

イ. 半導体事業

当社企業グループでは、メモリ、システムLSI、個別半導体の販売並びにシステムLSIの開発を行っております。当第3四半期連結累計期間は、デジタルAV用システムLSI及びカメラモジュール用ASIC等の売上が減少し、売上高は989億93百万円（前年同期比12.5%減）、営業利益は46億93百万円（前年同期比18.8%減）となりました。

ロ. 電子部品事業

当社企業グループでは、表示デバイス、電源、機構部品を販売しております。当第3四半期連結累計期間は、PND用及びデジタルスチルカメラ用液晶ディスプレイ等の売上が減少し、売上高は614億12百万円（前年同期比23.1%減）、営業利益は25億71百万円（前年同期比23.2%減）となりました。

ハ. 電子機器事業

当社企業グループでは、システム機器、設備機器を販売しております。当第3四半期連結累計期間は、アーケードゲーム向けシステム機器等の売上が減少し、売上高は164億55百万円（前年同期比3.4%減）、営業利益は3億78百万円（前年同期比27.6%減）となりました。

ニ. 生産事業

当社企業グループでは、ヒートシンク（半導体素子用放熱器）を生産し、販売しております。当第3四半期連結累計期間は、計測器用ヒートシンク等の売上が減少し、売上高は56億20百万円（前年同期比10.2%減）、営業利益は5億41百万円（前年同期比15.1%増）となりました。

(3) 所在地別セグメントの業績概況

イ. 日本

当第3四半期連結累計期間は、PND用液晶ディスプレイ及びカメラモジュール用ASIC等の売上が減少し、売上高は1,353億21百万円（前年同期比15.3%減）、営業利益は41億42百万円（前年同期比27.6%減）となりました。

ロ. アジア

当第3四半期連結累計期間は、デジタルAV用及びカーオーディオ用システムLSI等の売上がりが減少し、売上高は564億95百万円（前年同期比18.2%減）、営業利益は15億91百万円（前年同期比15.8%減）となりました。

2. 連結財政状態に関する定性情報

(1) 財政状態の状況

当第3四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べて127億35百万円減少し、1,612億87百万円となりました。

また、純資産は、前連結会計年度末に比べ17億26百万円減少して1,171億84百万円となり、自己資本比率は72.6%となりました。

(2) キャッシュ・フローの状況

当第3四半期末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて84百万円減少し、429億92百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第3四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が69億59百万円であったことに加え、売上債権が148億43百万円減少した為、仕入債務が93億85百万円減少したことや法人税等の支払いが41億57百万円あつたものの、全体で56億59百万円の資金の増加となりました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第3四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出30億円、有形固定資産の取得による支出1億81百万円及び貸付による支出1億16百万円等により33億14百万円の資金の減少となりました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第3四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、自己株式の取得による支出 12 億 70 百万円及び配当金の支払い 28 億 15 百万円等があった為、短期借入金が 21 億 96 百万円増加したものの 18 億 86 百万円の資金の減少となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

今後を展望いたしますと、世界経済は、先進国の景気後退、新興国の景気減速という世界同時不況の様相を呈しており、しばらくは大変厳しい経済環境が続くものと想定しております。なお、平成 20 年 10 月 30 日に公表した連結業績予想につきましては、第3四半期連結累計期間の業績結果に加え、第4四半期の事業環境も取引先の半導体、電子部品等の一層の需要低迷が想定されることから、次の通り修正いたします。

【連結業績予想】

	予想売上高	予想営業利益	予想経常利益	予想当期純利益	1 株当たり予想当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 錢
前回発表予想 (A)	260,000	8,400	9,300	5,700	162 99
今回修正予想 (B)	220,000	6,000	7,000	4,000	114 00
増減額 (B-A)	△40,000	△2,400	△2,300	△1,700	—
増減率 (%)	△15.4	△28.6	△24.7	△29.8	—
前期(平成 20 年 3 月期)	286,098	10,737	11,277	6,738	187 15

(参考)個別業績予想

	予想売上高	予想営業利益	予想経常利益	予想当期純利益	1 株当たり予想当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 錢
前回発表予想 (A)	190,000	5,600	7,500	4,300	122 96
今回修正予想 (B)	166,000	3,900	5,900	3,300	94 05
増減額 (B-A)	△24,000	△1,700	△1,600	△1,000	—
増減率 (%)	△12.6	△30.4	△21.3	△23.3	—
前期(平成 20 年 3 月期)	212,419	7,574	9,455	5,499	152 75

(事業の種類別セグメントの業績見通し)

イ. 半導体事業

半導体事業では、デジタルAV用システムLSI 及びカメラモジュール用ASIC 等の売上が減少すると見込まれることから、売上高は 1,160 億円（前期比 22.1% 減）、営業利益は 50 億円（前期比 31.1% 減）を予想しております。

ロ. 電子部品事業

電子部品事業では、PND用及びデジタルスチルカメラ用液晶ディスプレイ等の売上が減少すると見込まれることから、売上高は 753 億円（前期比 27.0% 減）、営業利益は 29 億円（前期比 34.1% 減）を予想しております。

ハ. 電子機器事業

電子機器事業では、磁気ヘッド製造用装置等の売上が減少すると見込まれることから、売上高は220億円（前期比14.3%減）、営業利益は3億80百万円（前期比62.4%減）を予想しております。

ニ. 生産事業

生産事業では、FA機器用ヒートシンク等の売上が減少すると見込まれることから、売上高は67億円（前期比20.1%減）、営業利益は5億20百万円（前期比29.6%減）を予想しております。

4. その他

- (1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）
該当事項はありません。
- (2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
影響額が僅少なものにつき、一部簡便的な手続きを採用しております。
- (3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 - ① 「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年3月14日 企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準適用指針」（企業会計基準委員会 平成19年3月14日 企業会計基準適用指針第14号）を第1四半期連結会計期間から適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。
 - ② 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による低価法によっておりましたが、第1四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（会計基準第9号）が適用されたことに伴い、主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。
この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益、営業利益及び経常利益が21百万円それぞれ減少し、税金等調整前四半期純利益が1億34百万円減少しております。
なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。
 - ③ 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会 平成18年5月17日 実務対応報告第18号）を第1四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な修正を行っております。

5. 【四半期連結財務諸表】
 (1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

	当第3四半期連結会計期間末 (平成20年12月31日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成20年3月31日)
資産の部		
流动資産		
現金及び預金	40,993	25,087
受取手形及び売掛金	71,142	87,219
有価証券	1,998	17,992
商品	18,172	16,313
製品	290	303
原材料	278	329
仕掛品	135	191
未収入金	2,668	2,287
繰延税金資産	312	525
その他	491	408
貸倒引当金	△166	△225
流动資産合計	136,317	150,432
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	5,188	5,402
土地	8,198	8,210
その他（純額）	762	996
有形固定資産合計	14,149	14,610
無形固定資産		
のれん	50	101
その他	523	585
無形固定資産合計	573	687
投資その他の資産		
投資有価証券	2,946	4,042
繰延税金資産	2,420	2,265
長期預金	3,500	500
その他	2,427	2,709
貸倒引当金	△976	△1,140
投資損失引当金	△71	△85
投資その他の資産合計	10,246	8,292
固定資産合計	24,970	23,590
資産合計	161,287	174,022

(単位：百万円)

当第3四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年3月31日)

負債の部			
流動負債			
支払手形及び買掛金	33,214	43,519	
短期借入金	5,610	4,090	
未払法人税等	278	2,120	
賞与引当金	459	—	
その他	1,921	2,916	
流動負債合計	41,485	52,646	
固定負債			
退職給付引当金	2,299	2,149	
その他	317	314	
固定負債合計	2,617	2,463	
負債合計	44,102	55,110	
純資産の部			
株主資本			
資本金	17,690	17,690	
資本剰余金	19,121	19,122	
利益剰余金	86,775	85,457	
自己株式	△4,206	△2,940	
株主資本合計	119,380	119,329	
評価・換算差額等			
その他有価証券評価差額金	△11	520	
繰延ヘッジ損益	△8	△6	
為替換算調整勘定	△2,285	△1,061	
評価・換算差額等合計	△2,306	△547	
少数株主持分	110	129	
純資産合計	117,184	118,911	
負債純資産合計	161,287	174,022	

(2) 【四半期連結損益計算書】
【第3四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

当第3四半期連結累計期間
(自 平成20年4月1日
至 平成20年12月31日)

売上高	182,481
売上原価	165,823
売上総利益	16,657
販売費及び一般管理費	
荷造運搬費	525
役員報酬	403
給料及び手当	2,710
賞与	1,019
退職給付費用	345
福利厚生費	601
減価償却費	445
その他	4,477
販売費及び一般管理費合計	10,528
営業利益	6,129
営業外収益	
受取利息	136
受取配当金	337
経営指導料	113
為替差益	198
その他	341
営業外収益合計	1,127
営業外費用	
支払利息	114
その他	27
営業外費用合計	141
経常利益	7,114
特別利益	
固定資産売却益	2
貸倒引当金戻入額	208
投資損失引当金戻入額	13
特別利益合計	224
特別損失	
固定資産除却損	33
たな卸資産評価損	112
投資有価証券評価損	225
ゴルフ会員権評価損	8
特別損失合計	380
税金等調整前四半期純利益	6,959
法人税、住民税及び事業税	2,391
法人税等調整額	429
法人税等合計	2,820
少数株主利益	4
四半期純利益	4,133

(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

当第3四半期連結累計期間
 (自 平成20年4月1日
 至 平成20年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー	
税金等調整前四半期純利益	6,959
減価償却費	583
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△208
退職給付引当金の増減額（△は減少）	156
受取利息及び受取配当金	△474
支払利息	114
有形固定資産除売却損益（△は益）	33
投資有価証券評価損益（△は益）	225
売上債権の増減額（△は増加）	14,843
たな卸資産の増減額（△は増加）	△2,236
仕入債務の増減額（△は減少）	△9,385
その他	△1,143
小計	9,468
利息及び配当金の受取額	462
利息の支払額	△114
法人税等の支払額	△4,157
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,659
投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の預入による支出	△3,000
有形固定資産の取得による支出	△181
有形固定資産の売却による収入	13
無形固定資産の取得による支出	△2
関係会社株式の取得による支出	△27
貸付けによる支出	△116
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,314
財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,196
自己株式の取得による支出	△1,270
自己株式の処分による収入	3
配当金の支払額	△2,815
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,886
現金及び現金同等物に係る換算差額	△542
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△84
現金及び現金同等物の期首残高	43,077
現金及び現金同等物の四半期末残高	42,992

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 平成19年3月14日)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号 平成19年3月14日)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) セグメント情報

[事業の種類別セグメント情報]

当第3四半期連結累計期間（自 平成20年4月1日 至 平成20年12月31日）

(単位：百万円)

	半導体 事業	電子部品 事業	電子機器 事業	生産事業	計	消去又 は全社	連 結
売上高及び営業損益							
売 上 高							
(1) 外部顧客に対する売上高	98,993	61,412	16,455	5,620	182,481	—	182,481
(2) セグメント間の内部売上高 又 は 振 替 高	—	—	—	—	—	—	—
計	98,993	61,412	16,455	5,620	182,481	—	182,481
営 業 費 用	94,299	58,841	16,077	5,078	174,296	2,055	176,351
営 業 利 益	4,693	2,571	378	541	8,184	(2,055)	6,129

(注) 1. 事業区分の方法及び各区分に属する主要な商品・製品の名称

(1) 事業区分の方法は、事業体制（組織）を基本とし、取扱商品、製品区分並びに販売形態等を勘案し、区分しております。

(2) 各事業区分の主要な商品・製品の名称

半導体事業 メモリ・システムLSI・個別半導体

電子部品事業 表示デバイス・電源・機構部品

電子機器事業 システム機器・設備機器

生産事業 ヒートシンク（半導体素子用放熱器）

2. 営業費用のうち、「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、2,055百万円であり、その主なものは、当社の企画・管理及び財経本部に係る費用であります。

3. 「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 平成18年7月5日)を第1四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、低価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。

その結果、従来の方法によった場合と比較して営業利益が「半導体事業」で15百万円、「電子部品事業」で5百万円及び「生産事業」で4百万円それぞれ減少しております。また、「電子機器事業」で3百万円増加しております。

(4) セグメント情報

[所在地別セグメント情報]

当第3四半期連結累計期間（自 平成20年4月1日 至 平成20年12月31日）

(単位：百万円)

	日本	アジア	計	消去又 は全社	連 結
売上高及び営業損益					
売　上　高					
(1) 外部顧客に対する売上高	126,226	56,255	182,481	—	182,481
(2) セグメント間の内部売上高 又　は　振　替　高	9,095	240	9,335	(9,335)	—
計	135,321	56,495	191,816	(9,335)	182,481
営　業　費　用	131,179	54,903	186,082	(9,731)	176,351
営　業　利　益	4,142	1,591	5,733	395	6,129

(注) 1. 国又は地域の区分は、地理的接近度によっております。

2. 各区分に属する主な国又は地域

アジア …… 香港・シンガポール・台湾・マレーシア等

3. 営業費用は、各セグメントへ配賦しております。

4. 「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 平成18年7月5日)を第1四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、低価法から原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)に変更しております。

その結果、従来の方法によった場合と比較して営業利益が「日本」で19百万円、「アジア」で2百万円それぞれ減少しております。

[海外売上高]

当第3四半期連結累計期間（自 平成20年4月1日 至 平成20年12月31日）

(単位：百万円)

	ア ジ ア	計
海外売上高	70,665	70,665
連結売上高	—	182,481
連結売上高に占める海外売上高の割合 (%)	38.7	38.7

(注) 1. 国又は地域の区分は、地理的接近度によっております。

2. 各区分に属する主な国又は地域

アジア …… 香港・韓国・中国・台湾等

3. 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高(ただし、連結関係会社の内部売上高を除く)であります。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。

「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表等

(1) 第3四半期連結損益計算書

(単位：百万円)

科 目	前第3四半期連結会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年12月31日)
	金 額
I 売 上 高	216,293
II 売 上 原 價	197,293
売 上 総 利 益	19,000
III 販売費及び一般管理費	10,881
営 業 利 益	8,118
IV 営 業 外 収 益	814
1. 受取利息及び配当金	236
2. 経営指導料	118
3. 為替差益	6
4. 保険料解約返戻金	114
5. その他の	338
V 営 業 外 費 用	271
1. 支 払 利 息	197
2. その他の	74
経常利益	8,661
VI 特 別 利 益	34
1. 固定資産売却益	1
2. 貸倒引当金戻入益	32
3. その他の	1
VII 特 別 損 失	79
1. 固定資産除却及び売却損	31
2. 投資有価証券評価損	47
税金等調整前四半期純利益	8,616
法人税、住民税及び事業税	3,185
法 人 税 等 調 整 額	284
少数株主利益(△:損失)	△0
四 半 期 純 利 益	5,145

(2) 第3四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

		前第3四半期連結会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年12月31日)
区 分		金 額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益		8,616
減 債 償 却 費		645
貸 倒 引 当 金 の 増 減 額 (減 少 : △)	△	32
退職給付引当金の増減額 (減少 : △)		123
受取利息及び受取配当金	△	236
支 払 利 息		197
有形固定資産売却益	△	1
有形固定資産除却及び売却損		31
売 上 債 権 の 増 減 額 (増 加 : △)		6,545
棚 卸 資 產 の 増 減 額 (増 加 : △)	△	683
仕 入 債 務 の 増 減 額 (減 少 : △)	△	4,270
そ の 他	△	1,278
小 計		9,657
利 息 及 び 配 当 金 の 受 取 額		249
利 息 の 支 払 額	△	196
法 人 税 等 の 支 払 額	△	4,723
営業活動によるキャッシュ・フロー		4,987
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
定 期 預 金 の 純 増 減 額 (増 加 : △)	△	14
有形固定資産の取得による支出	△	311
有形固定資産の売却による収入		7
無形固定資産の取得による支出	△	4
投資有価証券の取得による支出	△	199
貸付金の回収による収入		102
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	420
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
短 期 借 入 金 の 純 増 減 額 (減 少 : △)		55
自己株式の取得による支出	△	2,883
配 当 金 の 支 払 額	△	2,897
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	5,724
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額		104
V 現金及び現金同等物の増減額 (減 少 : △)	△	1,053
VI 現金及び現金同等物の期首残高		40,880
VII 現金及び現金同等物の四半期末残高		39,827

(3) セグメント情報

[事業の種類別セグメント情報]

前第3四半期連結会計期間（自 平成19年4月1日 至 平成19年12月31日）

(単位：百万円)

	半導体 事業	電子部品 事業	電子機器 事業	生産事業	計	消去又 は全社	連 結
売上高及び営業損益							
売 上 高							
(1) 外部顧客に対する売上高	113,154	79,843	17,040	6,255	216,293	—	216,293
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	—	—	—
計	113,154	79,843	17,040	6,255	216,293	—	216,293
営 業 費 用	107,371	76,493	16,518	5,784	206,168	2,006	208,175
営 業 利 益	5,783	3,349	522	470	10,125	(2,006)	8,118

(注) 1. 事業区分の方法及び各区分に属する主要な商品・製品の名称

(1) 事業区分の方法は、事業体制（組織）を基本とし、取扱商品、製品区分並びに販売形態等を勘案し、区分しております。

(2) 各事業区分の主要な商品・製品の名称

半導体事業 メモリ・システムLSI・個別半導体

電子部品事業 表示デバイス・電源・機構部品

電子機器事業 システム機器・設備機器

生産事業 ヒートシンク（半導体素子用放熱器）

2. 営業費用のうち、「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は2,006百万円であり、その主なものは、当社の情報システム投資並びに企画・管理及び財経本部に係る費用であります。

〔所在地別セグメント情報〕

前第3四半期連結会計期間（自 平成19年4月1日 至 平成19年12月31日）

(単位：百万円)

	日本	アジア	計	消去又 は全社	連 結
売上高及び営業損益					
売 上 高					
(1) 外部顧客に対する売上高	147,571	68,722	216,293	—	216,293
(2) セグメント間の内部売上高 又 は 振 替 高	12,188	366	12,554	(12,554)	—
計	159,759	69,088	228,848	(12,554)	216,293
営 業 費 用	154,039	67,199	221,238	(13,063)	208,175
営 業 利 益	5,720	1,889	7,609	508	8,118

(注) 1. 国又は地域の区分は、地理的接近度によっております。

2. 各区分に属する主な国又は地域

アジア …… 香港・シンガポール・台湾・マレーシア等

3. 営業費用は、各セグメントへ配賦しております。

〔海外売上高〕

前第3四半期連結会計期間（自 平成19年4月1日 至 平成19年12月31日）

(単位：百万円)

	ア ジ ア	計
海外売上高	87,308	87,308
連結売上高	—	216,293
連結売上高に占める海外売上高の割合 (%)	40.4	40.4

(注) 1. 国又は地域の区分は、地理的接近度によっております。

2. 各区分に属する主な国又は地域

アジア …… 香港・韓国・中国・台湾等

3. 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高（ただし、連結関係会社の内部売上高を除く）であります。